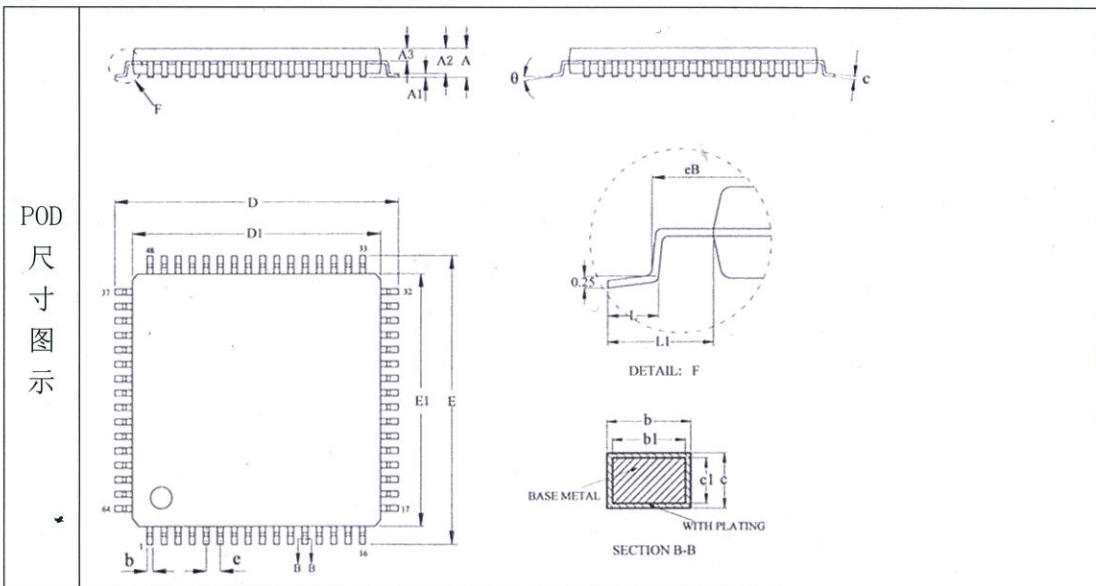


# HC32L176/L196/F176/F196 LQFP100 系列

## 产能扩充的通知

客户名称	ALL	联系人	NA
------	-----	-----	----

受影响产品	商业名称	物料编码
	HC32L196PCTA-LQFP100	2L196PC0-0153A0AQ0T
	HC32L176PATA-LQFP100	2L176PA0-0153A0AQ0T
	HC32F176PATA-LQFP100	2F176PA0-0153A0AQ0T
	HC32F196PCTA-LQFP100	2F196PC0-0153A0AQ0T

变更原因描述	为应对 2022 年封装测试产能紧张，为保障对客户的供货，封装测试供应商扩充通富微电。						
变更方法描述	<p>1. 封装测试供应商扩充</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>封装类型</th> <th>现有封装测试供应商</th> <th>扩充后封装测试供应商</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LQFP100</td> <td>天水华天科技股份有限公司</td> <td>天水华天科技股份有限公司及通富微电子股份有限公司</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 扩充的封装测试供应商通富微电为国内排名前三的供应商，且华大均有相同封装类型的其他产品导入量产；</p> <p>3. 扩充至封装测试供应商通富微电后，封装芯片外形尺寸除了引脚宽度尺寸 <math>b</math> 从 <math>0.22 \pm 0.04\text{mm}</math> 变为 <math>0.225 \pm 0.045\text{mm}</math> 外，其它尺寸和其它型号尺寸无明显变化；</p> <p>POD 尺寸图示：</p>  <p>4. 扩充至封装测试供应商通富微电后，芯片表面印章第三行最后一位字母有变化，N 为通富微</p>	封装类型	现有封装测试供应商	扩充后封装测试供应商	LQFP100	天水华天科技股份有限公司	天水华天科技股份有限公司及通富微电子股份有限公司
封装类型	现有封装测试供应商	扩充后封装测试供应商					
LQFP100	天水华天科技股份有限公司	天水华天科技股份有限公司及通富微电子股份有限公司					

电, T 为天水华天, 如下图:

5. 扩产至封装测试供应商通富微电后, 芯片表面的 Pin 孔有变化, 不影响芯片的使用, 如下图:

天水华天	通富微电
表面 1 个孔 (左上为 Pin1) 印章第三行最后一位字母为 T	表面 3 个孔 (左上为 Pin1) 印章第三行最后一位字母为 N
	

6. 包装及标识没有变化

7. 变更验证计划

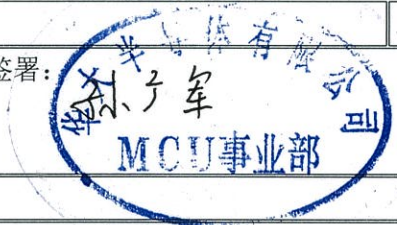
	待验证厂家	计划验证完成时间	样品准备完成时间
LQFP100 14*14*1.4 e=0.5	通富微电	2022-4-11	2022-2月中旬

8. 变更前在途、在库产品

变更验证通过前涉及物料保持原供应商继续生产, 销售接单不受影响

变更生效日期或产品 Date Code 说明: 从 2022 年 4 月开始按照验证计划生效

发行人	康超	发行日期	2021/12/10
工程运营副总经理签署:		日期: 2021.12.14	



客户	部确认意见:
签署:	日期:

✎ 以上, 特此通知, 如果您有任何意见或建议, 请随时与我司销售部门联系。✎